

臻鼎科技控股 (4958 TT)

2023年第4季暨全年法人說明會

2024年3月12日

- 本簡報及同時發佈之相關訊息內，含有從公司內部與外部來源所取得的預測性資訊。
- 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



簡報大綱

1

2023年第4季暨全年營運成果

江謙逸 財務長

2

策略布局

沈慶芳 董事長

3

IC載板營運規劃與執行

李定轉 董事及營運長

2023年第4季暨全年營運成果

江謙逸 財務長

單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外
季變化 (%) 年變化 (%)

	4Q23	3Q23	4Q22	季變化 (%)	年變化 (%)
營業收入	54,396	41,919	52,902	29.8%	2.8%
營業毛利	11,679	8,583	13,913	36.1%	-16.1%
營業毛利率	21.5%	20.5%	26.3%	+1.0ppts	-4.8ppts
營業費用	5,424	5,008	5,219	8.3%	3.9%
營業利益	6,254	3,575	8,694	74.9%	-28.1%
營業利益率	11.5%	8.5%	16.4%	+3.0ppts	-4.9ppts
營業外收入及支出	(409)	222	(973)		
本期淨利	5,070	3,349	6,857	51.4%	-26.1%
淨利率	9.3%	8.0%	13.0%	+1.3ppts	-3.7ppts
歸屬於母公司之淨利	3,504	2,271	4,705	54.3%	-25.5%
每股盈餘 (新台幣元) ⁽¹⁾	3.71	2.40	4.98		
營運活動之現金流入	13,248	5,143	15,458	157.6%	-14.3%
資本支出	6,233	4,801	5,569	29.8%	11.9%
現金及約當現金 ⁽²⁾	65,970	59,979	48,957	10.0%	34.8%
股東權益報酬率 (%) ⁽³⁾	15.2%	10.0%	22.3%	+5.2ppts	-7.1ppts

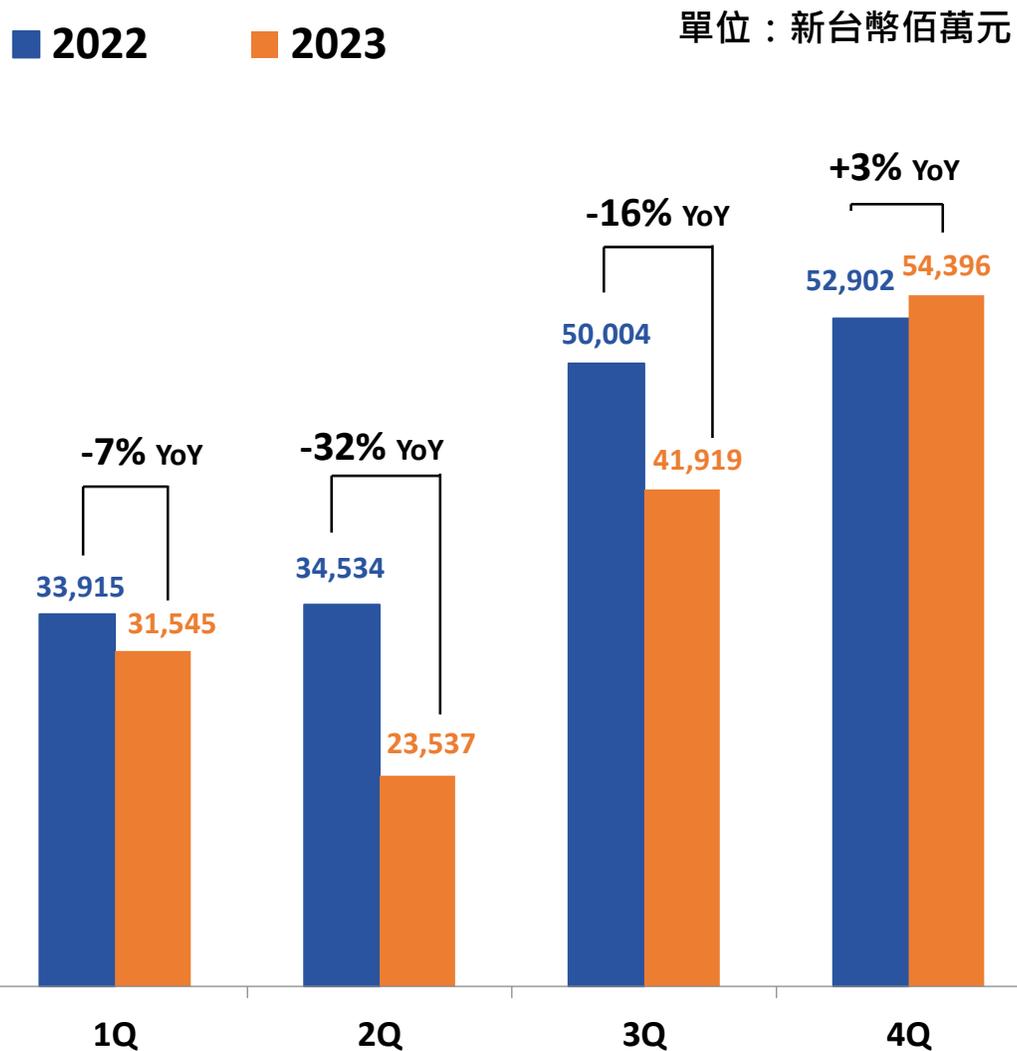
附註：(1) 2023年加權平均流通在外股數為944,956仟股 (實際發行股本947,049仟股-庫藏股2,093仟股)。 (2)現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。 (3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

單位: 新台幣佰萬元, 除另予註明者外

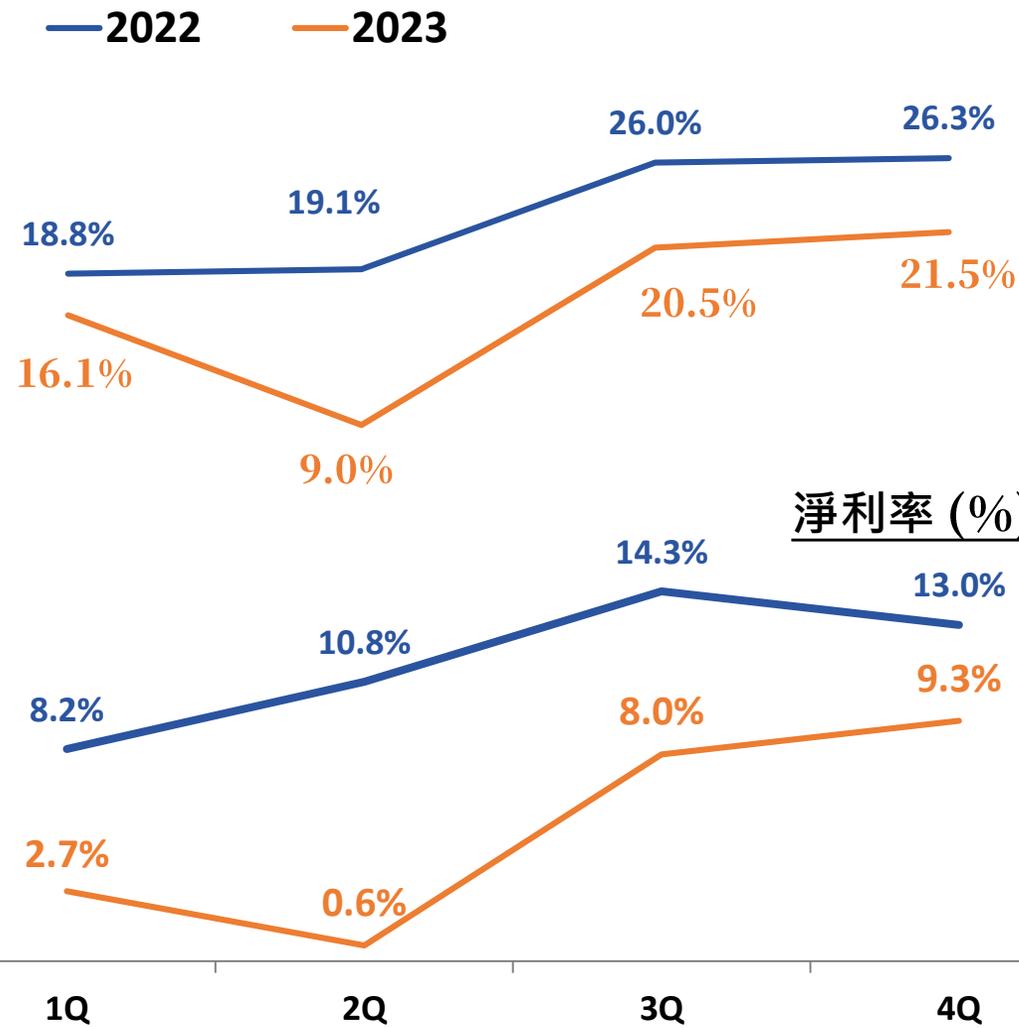
	2023	2022	年變化 (%)
營業收入	151,398	171,356	-11.6%
營業毛利	27,459	39,888	-31.2%
營業毛利率	18.1%	23.3%	-5.2ppts
營業費用	18,300	17,441	4.9%
營業利益	9,160	22,447	-59.2%
營業利益率	6.1%	13.1%	-7.0ppts
營業外收入及支出	888	1,022	-13.1%
本期淨利	9,432	20,535	-53.8%
淨利率	6.2%	12.0%	-5.8ppts
歸屬於母公司之淨利	6,189	14,197	-56.4%
每股盈餘 (新台幣元) ⁽¹⁾	6.55	15.02	
營運活動之現金流入	33,608	45,311	-25.8%
資本支出	26,066	29,032	-10.2%
現金及約當現金 ⁽²⁾	65,970	57,599	14.5%
股東權益報酬率 (%) ⁽³⁾	7.1%	16.7%	-9.6ppts

附註：(1) 2023年加權平均流通在外股數為944,956仟股 (實際發行股本947,049仟股-庫藏股2,093仟股)。(2)現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。(3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

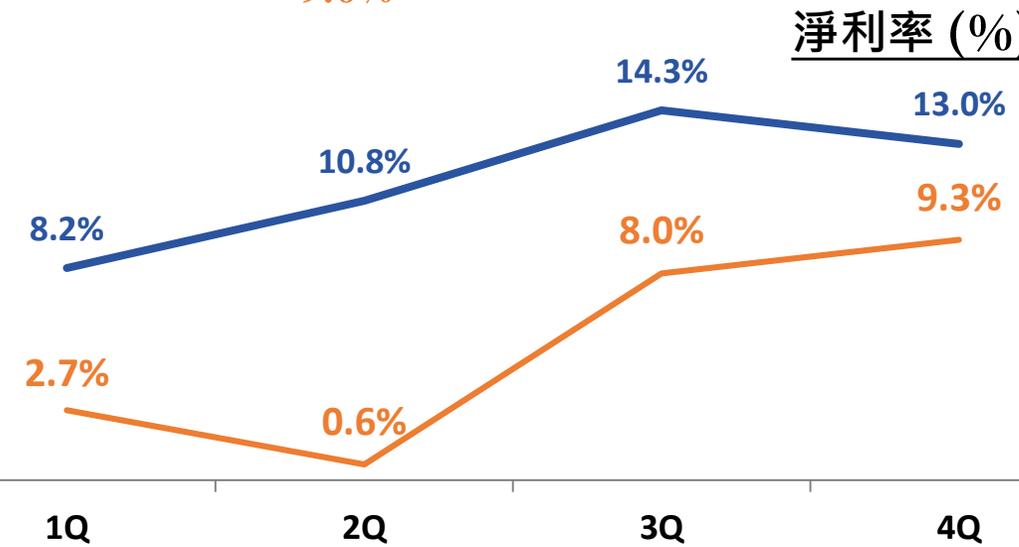
營業收入



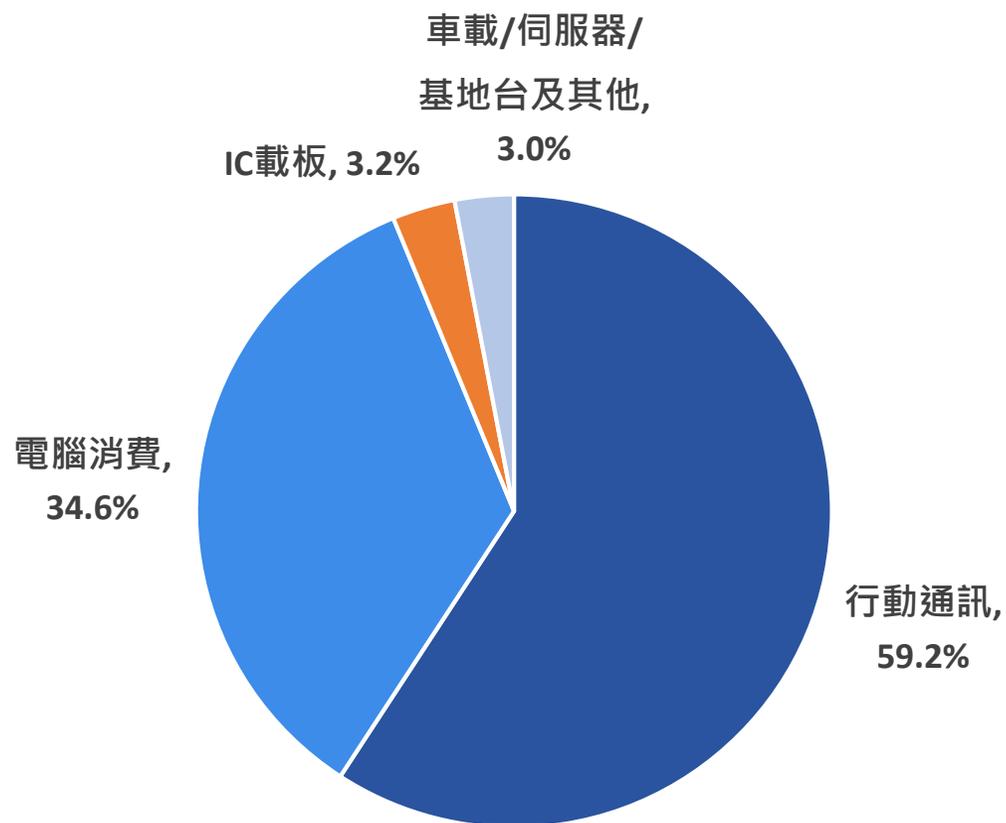
毛利率 (%)



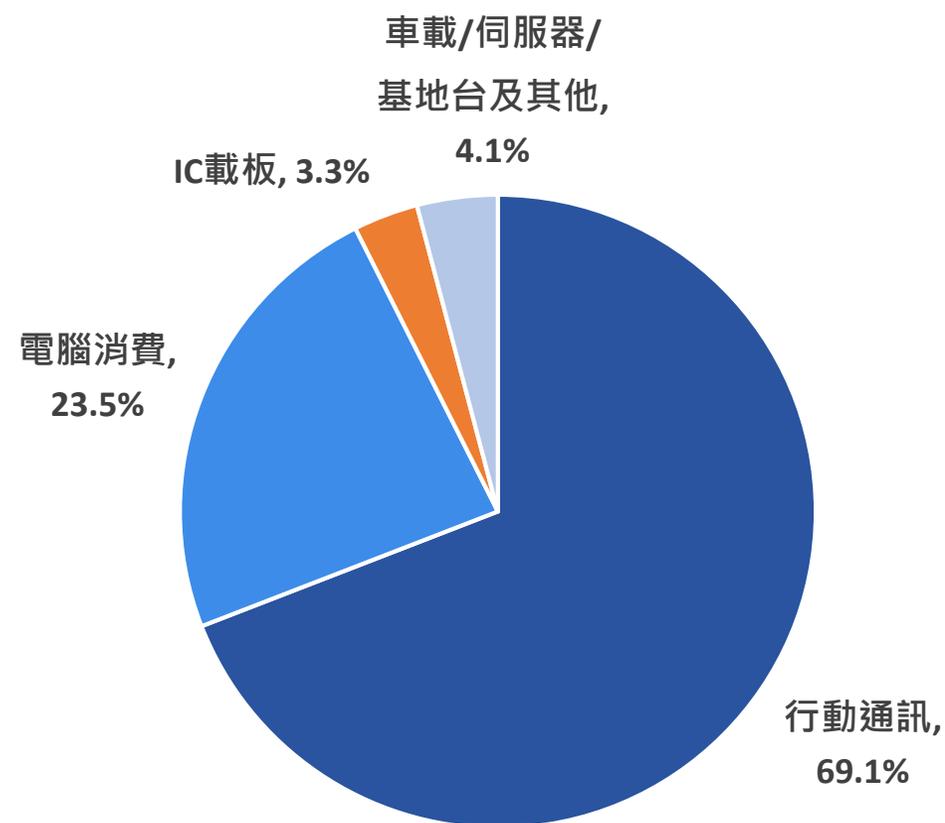
淨利率 (%)



2022年營收新台幣1,714億



2023年營收新台幣1,514億



資產負債表及重要財務比率

	2023-12-31		2022-12-31		單位：新台幣佰萬元 差異	
	金額	%	金額	%	金額	%
現金及約當現金 ⁽²⁾	65,970	27.2%	57,599	24.8%	8,371	+2.4ppts
應收款項	29,503	12.2%	30,529	13.1%	-1,026	-0.9ppts
存貨	15,508	6.4%	17,725	7.6%	-2,217	-1.2ppts
不動產、廠房及設備 ⁽³⁾	109,965	45.3%	104,814	45.1%	5,151	+0.2ppts
資產總額	242,932	100.0%	232,560	100.0%	10,372	
借款	53,130	21.9%	45,359	19.5%	7,771	+2.4ppts
應付款項	37,853	15.6%	37,082	15.9%	771	-0.3ppts
負債總額	108,450	44.7%	99,694	42.9%	8,756	
股東權益總額	134,326	55.3%	132,866	57.1%	1,460	-1.8ppts
重要財務比率						
平均收現日數(天)	72		72		-	
平均銷貨日數(天)	52		52		-	
流動比率(倍)	1.44		1.49		(0.05)	
資產生產力(倍) ⁽⁴⁾	1.47		1.84		(0.37)	

附註：(1) 2023年加權平均流通在外股數為944,956仟股 (實際發行股本947,049仟股-庫藏股2,093仟股)。(2)現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等。(3) 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據。

單位：新台幣佰萬元

年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
營業收入	64,483	75,954	85,738	82,393	109,238	117,913	120,068	131,279	155,022	171,356	151,398
營業毛利	11,894	14,323	16,427	12,542	17,833	26,061	27,222	26,584	30,537	39,888	27,459
本期淨利	5,471	6,735	7,731	3,456	6,772	11,536	12,402	11,508	13,694	20,535	9,432
母公司淨利	5,471	6,735	7,731	3,456	5,172	8,448	8,685	8,095	9,651	14,197	6,189
折舊及攤銷	3,742	4,293	4,850	5,295	5,679	6,820	7,955	8,405	11,875	14,638	16,323
每股盈餘 (元)	7.41	9.12	9.80	4.29	6.43	10.50	9.93	8.90	10.21	15.02	6.550
每股股利 (元)	3.00	3.67	4.50	2.20	3.30	4.46	4.50	4.50	5.00	6.00	3.275
分派比率 (%)	40.5%	40.2%	45.9%	51.3%	51.3%	42.5%	45.3%	50.6%	49.0%	40.0%	50.0%
現金及約當現金 *	10,016	23,482	31,572	30,241	33,296	49,154	43,071	46,775	35,179	57,599	65,970
不動產、廠房及設備	27,843	30,073	32,074	32,262	36,681	41,913	46,243	68,177	86,073	104,814	109,965
資本額	7,386	7,386	8,047	8,047	8,047	8,047	9,022	9,470	9,470	9,470	9,470
股東權益報酬率 (%)	23.77%	23.33%	20.82%	8.59%	14.49%	17.30%	14.72%	11.84%	12.59%	16.67%	7.10%
負債比率 (%)	64.06%	62.54%	53.70%	59.72%	55.33%	44.25%	35.41%	42.56%	42.01%	42.87%	44.67%

* 現金及約當現金包含按攤銷後成本衡量之金融資產的定期存款等

策略布局

沈慶芳 董事長

1

2023年營收年減11.6%，符合公司先前預期，且優於產業平均年減幅度(年減15%)：

2023年受到全球消費性電子需求不振影響，臻鼎營收自2017年以來首度年減，但營收年減幅度優於產業平均，主要受惠One ZDT 策略奏效，產品組合分散至多元應用，2023年車載/高速運算伺服器/基地台相關營收逆勢年增19%。

2

2024年營收預期溫和成長，產品組合結構性調整延續，IC載板、伺服器、車載營收動能升溫：

2023年谷底已過，臻鼎2024年將延續產品結構調整的基調，預期消費性電子溫和復甦，同時其他多元應用，包含IC載板、伺服器與車載營收皆目標雙位數成長，2025年更是加速成長。

3

隨著Edge AI 導入更多功能，推升終端裝置升級高階PCB/IC載板的需求，臻鼎可望大幅受益：

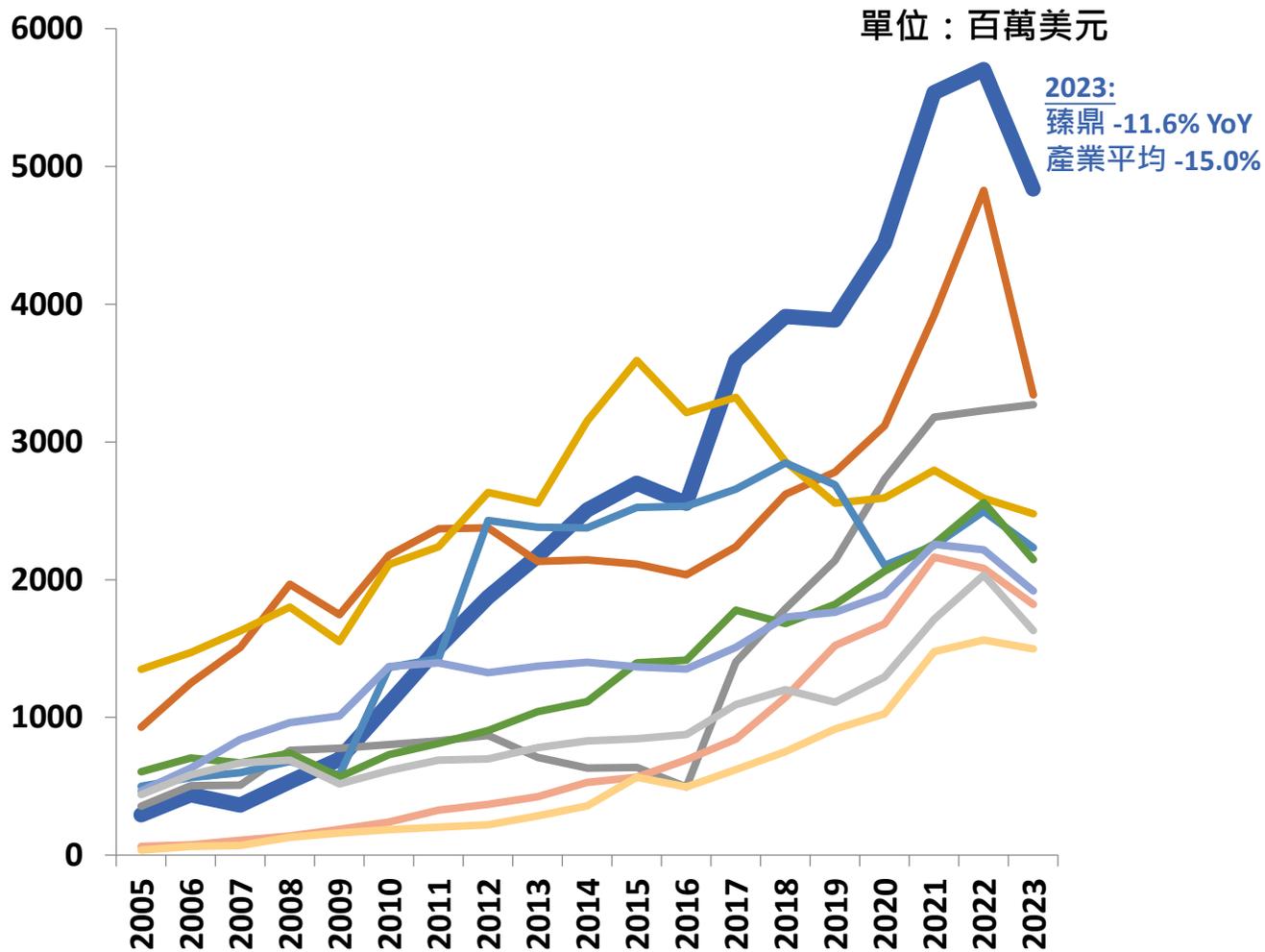
在Edge AI 趨勢下，終端裝置包含手機、PC/NB等將逐步導入各種AI應用，推升細線路、高層數的高階PCB板/IC載板需求。臻鼎為全球高階PCB板/IC載板的領導廠商，可望受益於Edge AI 趨勢。

4

泰國新廠已於去年12月動土，完善公司全球化生產佈局：

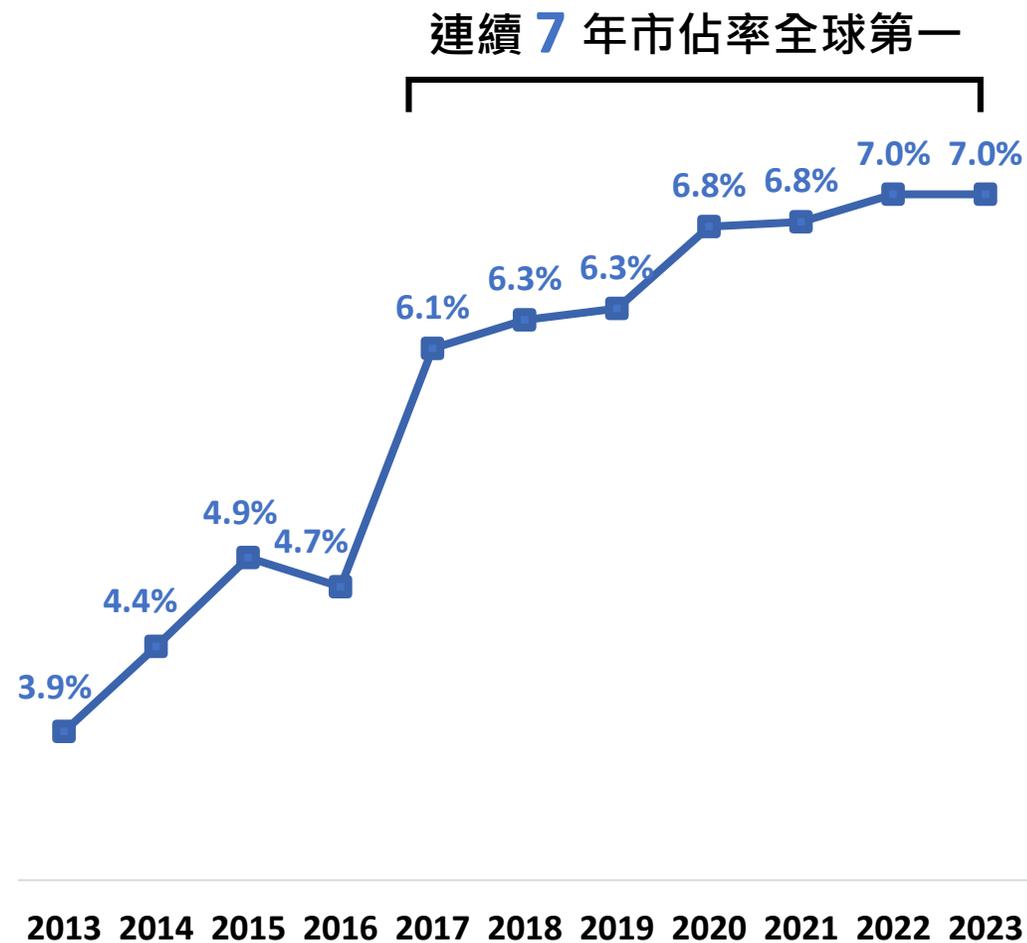
泰國廠於去年12月啟動建廠，第一期投資金額為2.5億美金，目前依照規劃進度正全力進行基礎建設，目標仍維持在1H25試產、2H25小量產，成為東南亞製造重要據點。

2023全球前十大PCB領導廠商營收趨勢



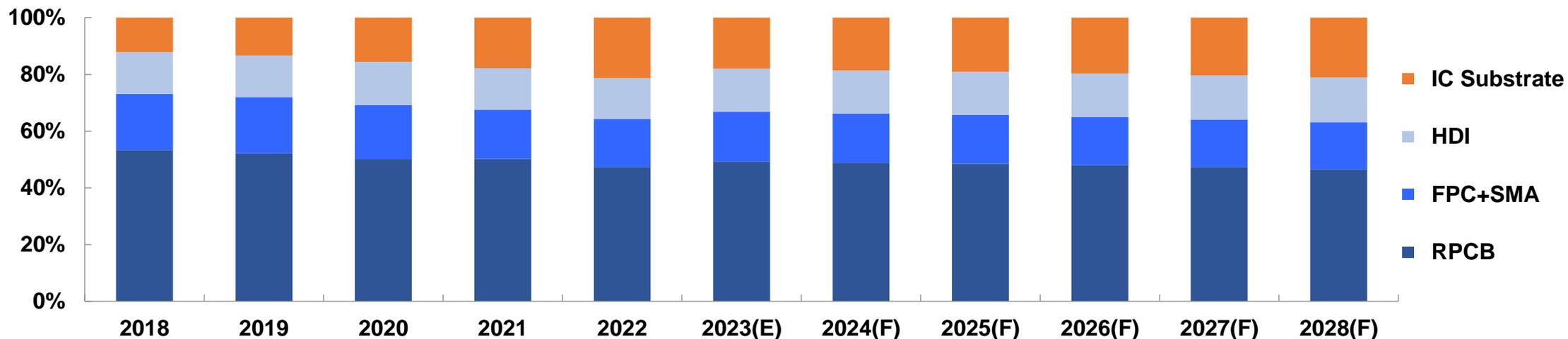
資料來源：NT Information；Prismark (2024/02)

臻鼎持續保持PCB產業領先市佔率



資料來源：Prismark

各類PCB市場規模將於2024年重回成長軌道



產品	項目	2018	2019	2020	2021	2022	2023(E)	2024(F)	2025(F)	2026(F)	2027(F)	2028(F)	2023-2028 CAGR
RPCB	產值	33,225	31,969	32,674	40,641	38,720	34,292	35,659	37,554	39,240	40,724	42,005	4.1%
	佔全球比	53.2%	52.1%	50.1%	50.2%	47.4%	49.3%	48.9%	48.5%	48.0%	47.3%	46.5%	
FPC+SMA	產值	12,395	12,195	12,483	14,058	13,842	12,191	12,649	13,225	13,828	14,458	15,117	4.4%
	佔全球比	19.9%	19.9%	19.1%	17.4%	16.9%	17.5%	17.3%	17.1%	16.9%	16.8%	16.7%	
HDI	產值	9,222	9,008	9,874	11,811	11,763	10,536	11,095	11,806	12,563	13,369	14,226	6.2%
	佔全球比	14.8%	14.7%	15.1%	14.6%	14.4%	15.2%	15.2%	15.3%	15.4%	15.5%	15.7%	
IC Substrate	產值	7,554	8,139	10,188	14,410	17,415	12,498	13,568	14,772	16,083	17,511	19,065	8.8%
	佔全球比	12.1%	13.3%	15.6%	17.8%	21.3%	18.0%	18.6%	19.1%	19.7%	20.3%	21.1%	
合計		62,396	61,311	65,219	80,920	81,740	69,517	72,971	77,358	81,715	86,062	90,413	5.4%
年增率		6.0%	-1.7%	6.4%	24.1%	1.0%	-15.0%	5.0%	6.0%	5.6%	5.3%	5.1%	

資料來源：Prismark(2024/2)；2025~27年係用Prismark數據推估。

FPC (+Module)

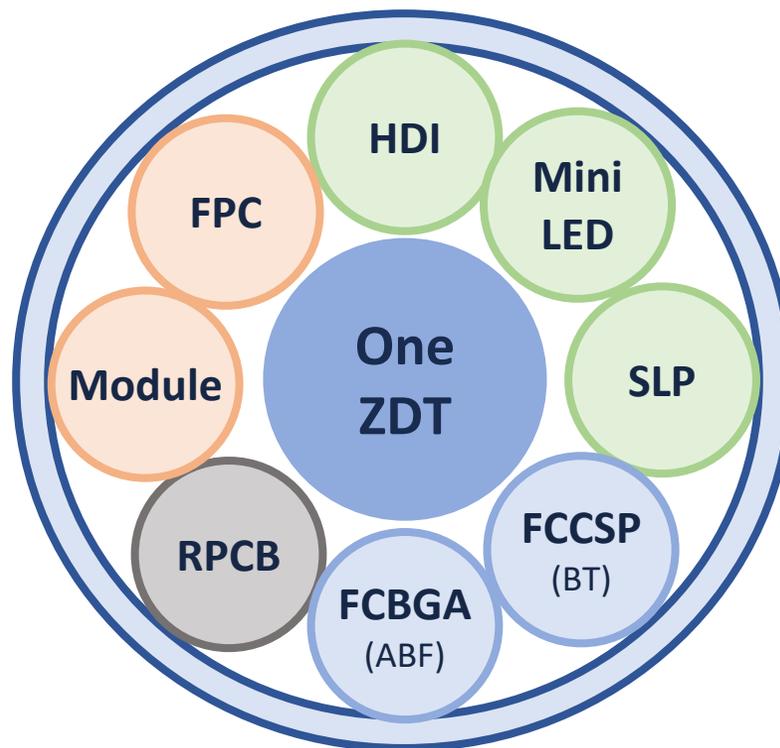


AI手機 AR/VR 元宇宙 智能穿戴 新能源車電池板 次世代顯示屏

RPCB(+基站+汽車板+伺服器)



AI 伺服器 邊緣運算伺服器 車用毫米波雷達 智能車用 高頻通訊基站



HDI(+mSAP+Mini LED)



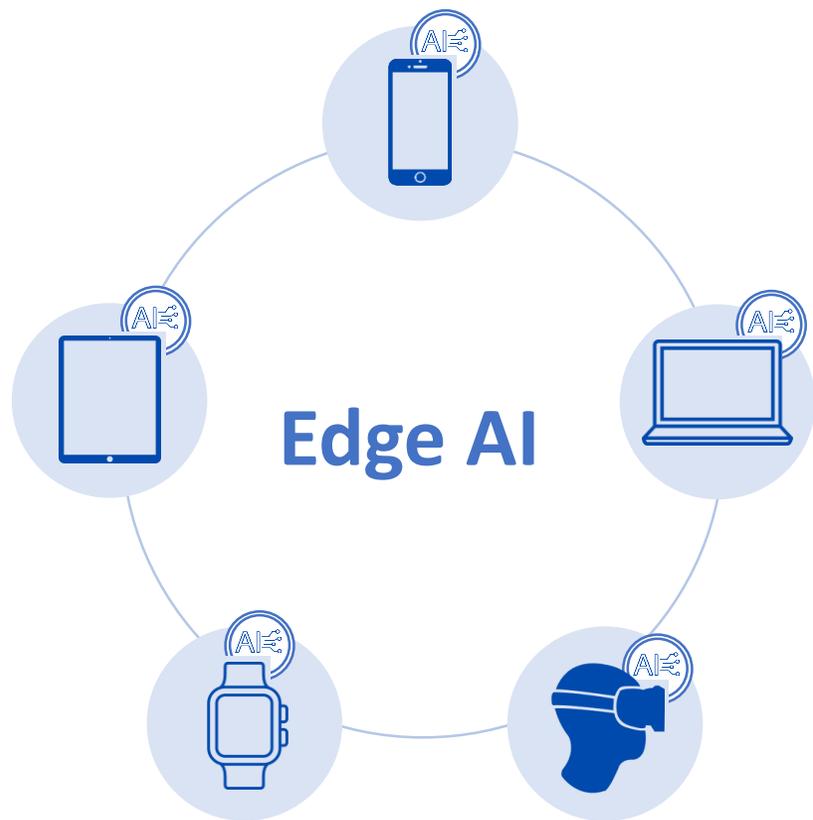
AI手機 AI PC AR/VR 元宇宙 智能穿戴 智慧座艙

IC載板(FCCSP+FCBGA)



AI 手機晶片 高速運算記憶體 自動駕駛車用晶片

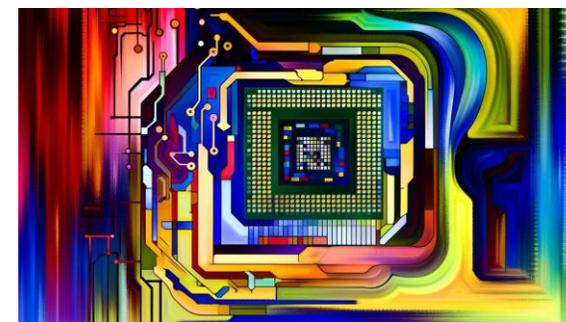
AI應用朝多元化發展，將使PCB板設計趨於複雜，對於IC載板、高階HDI、FPC需求看增。



可執行各種AI應用，包含即時翻譯、語音筆記助理、圖像編輯助理等多元應用。

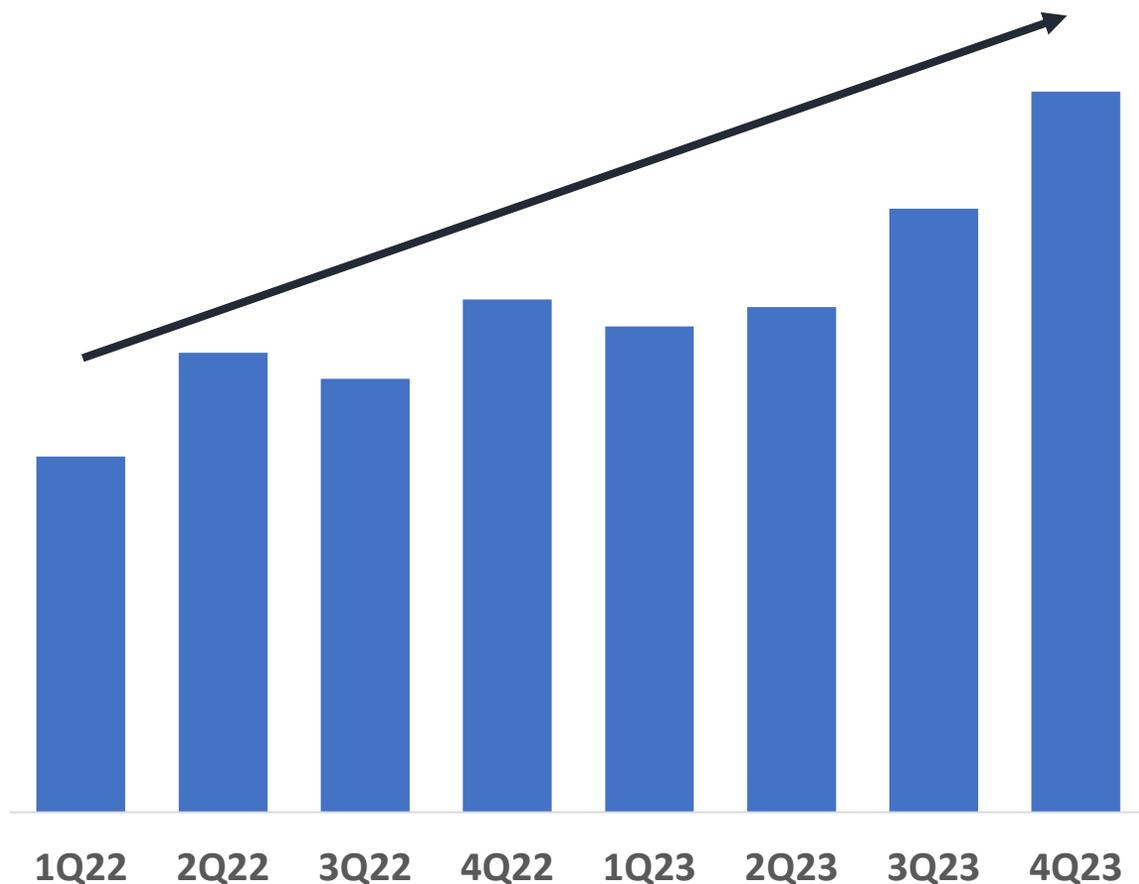
人機介面朝多元化發展，包含聲音、手勢、眼神等。

PCB板/IC載板設計更趨複雜，細線路、高層數的高階板需求日益增加。

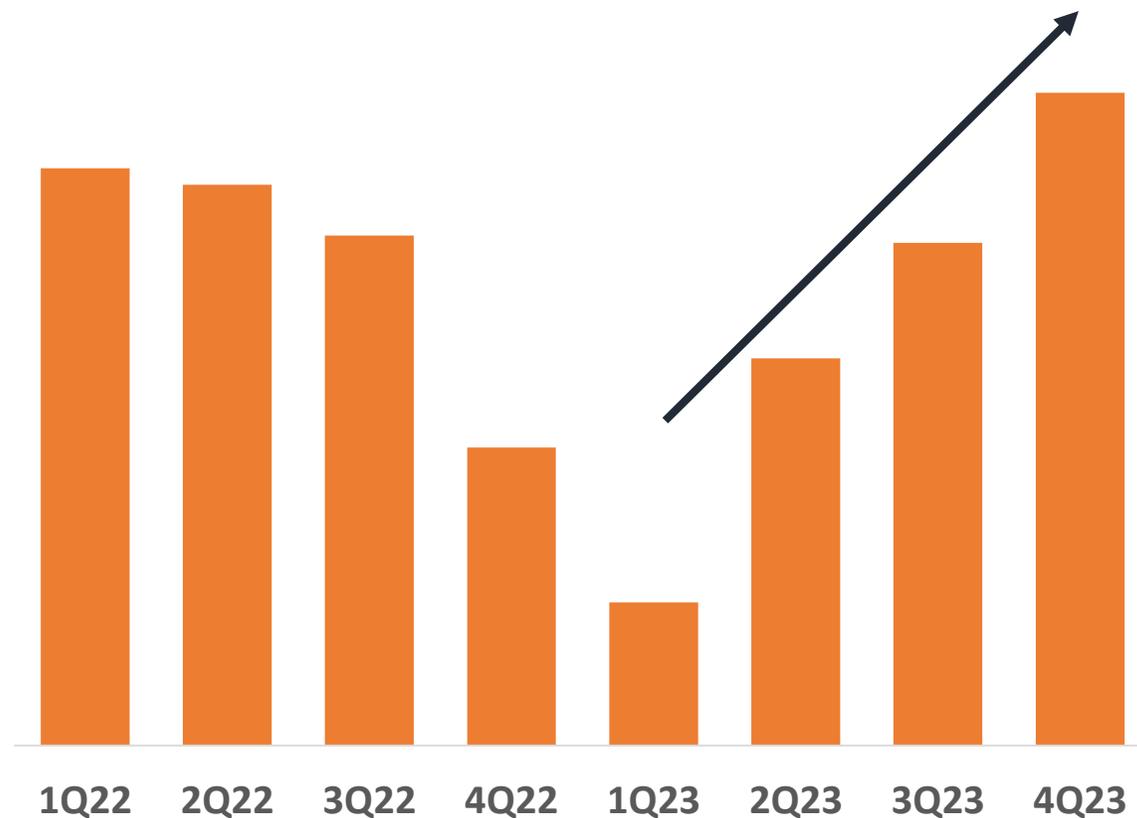


臻鼎為全球高階PCB板/IC載板的領導廠商，在Edge AI 趨勢下深具競爭優勢。

臻鼎車載/高速運算伺服器/基地台營收屢創新高



臻鼎IC載板營收單季營收於4Q23亦創新高



高雄路竹科學園區：軟板與先進模組的生產線



- 預計2H24將正式投產
- 為最高階的軟板工廠，預期將配合客戶開發高階新品

泰國巴真府園區第一期：高階 RPCB/HDI



- 預計1H25試產、2H25小量產
- 第一期產能以高階RPCB/HDI為主
- 為臻鼎東南亞製造重要據點

多廠區生產基地，貼近客戶需求



▶ 臺灣公司治理評鑑

2023年公司治理評鑑排名上市公司6%-20%，再度**入選臺灣證券交易所公司治理100指數**。

▶ 標普全球企業永續評鑑 S&P Global ESG

2023年S&P Global ESG 評級進步至73分，連續2年**入選標普全球永續年鑑 (Sustainability Yearbook)**，為唯一入選的PCB企業。

▶ Sustainalytics ESG 風險評級

2023年Sustainalytics ESG風險評級由17.8進步至15.6，為**低等風險等級**。

▶ ISS ESG 評級

最新年度的ISS ESG評級由「C」進步至「C+」，獲得「**優秀 (Prime)**」等級。

▶ CDP 碳揭露專案

2023年在氣候變遷獲得「B」等級，較去年進步一個等級。在水安全管理獲得「**A-**」**領導等級殊榮**，亦較去年進步一等級。

▶ 富時羅素 FTSE Russell ESG

最新年度的FTSE Russell ESG評級獲得4.3分（滿分為5分），成為**台灣上市櫃公司並列第四名**。

IC載板營運規劃與執行

李定轉 董事及營運長

1

IC載板營收於4Q23創下單季新高，BT載板持續回溫，2024年平均產能利用率逾80%+，可望轉虧為盈：

- BT載板產能利用率在4Q23已回升至超過70%，優於先前預期，今年產能利用率將進一步提升，並可望轉虧為盈。

2

ABF載板陸續通過客戶認證及量產，營收與產能利用率預期逐季走高：

- ABF載板方面，AI及車載需求佳，臻鼎積極布局這兩大領域相關客戶，並陸續通過客戶認證及量產，預期營收與產能利用率可望逐季走高。

3

臻鼎對於來自國際客戶的「China for China」需求極具優勢：

- 為取得更多市場份額，國際客戶進入大陸市場逐漸需要佈建大陸本地產能，臻鼎擁有大陸最先進的IC載板廠，將可支應國際客戶「China for China」的需求，極具競爭優勢。

4

聚焦持續開發高密度、細線路產品：

- ABF載板方面，已開始與客戶開發Chiplet使用之高階載板。現出貨18~20層單顆最大尺寸92mm x 92mm產品，良率達ABF載板tier 1 供應商水準。單顆尺寸102mm x 102mm已出貨供客人測試。
- BT載板方面，佈局ETS細線路6/8um，亦為業界tier 1領先水準。

AI應用-Chiplet 小晶片載板

AI

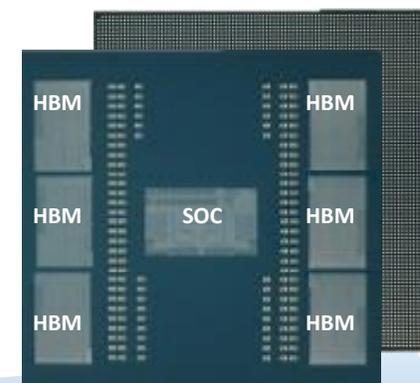


AI應用除需高速運算功能，
還需搭配快速讀寫記憶體空間

晶片解決方案



小晶片載板



載板需求技術

高層數	大尺寸	微孔	細線路	銅面處理技術
✓ 18~20層	✓ 90x90 ~ 95x95mm	✓ 40 ~ 60 um	✓ 9~15 um	✓ 低粗糙度，高結合力

臻鼎
IC載板

智能化



網域控制站

- 智駕網域控制站
- 座艙網域控制站

感測器

- 毫米波雷達
- 雷射雷達
- 攝像頭

使用晶片

自動駕駛AI晶片 影像感測器
智慧座艙晶片 存儲晶片
網域控制站DCU晶片 ADAS運算晶片

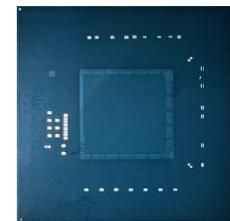


封裝方式

FCBGA
CSP

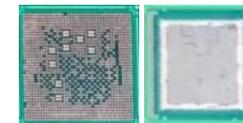
ZDT載板

FCBGA



4~18L
17x17~75x75mm

FCCSP



2~4L
7x7~21x21mm

WBCSP



2~4L
7x7~27x27mm

互聯化



通信模組

- 遠端通訊盒

車聯網

- 5G 模組

智慧座艙晶片



FCCSP

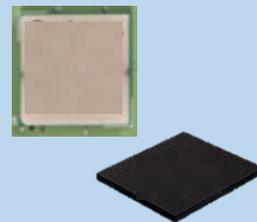
信息化



顯示系統

- HUD抬頭顯示
- AR/VR虛擬增強現實
- NFC近場通信

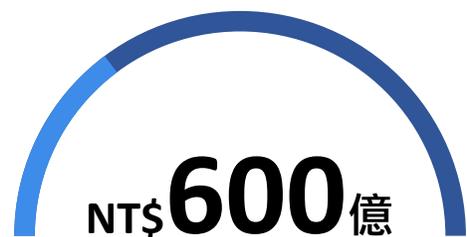
智慧座艙晶片
存儲晶片



FCCSP
CSP

IC載板產能規劃

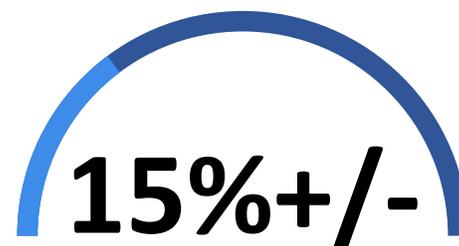
		2023				2024				2025				2026			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
深圳 ABF載板 (兩廠樓地板面積共17萬平米)	Fab 1 (中高階產品)	裝機															
		樣品認證															
		量產，目標良率與tier 1競爭對手相當								產能滿載，目標良率與tier 1競爭對手相當							
Fab 2 (高階產品)										裝機							
										樣品認證							
														量產			
秦皇島 BT載板 (兩廠樓地板面積共6萬平米)	Fab 1	技術與品質領先業界															
	Fab 2	量產				平均稼動率 80%+				技術與品質領先業界							



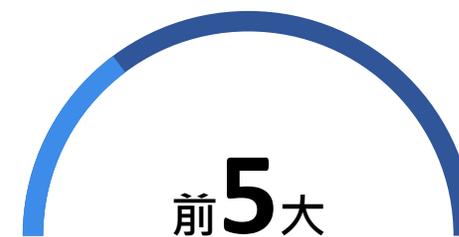
IC載板資本支出：
2022-2027規劃投資600億



IC載板營收：
2023-2027複合成長率 >50%



IC載板營收：
至2027年，IC載板占臻鼎合併營收15%+/-



IC載板市占率：
目標2030年成為IC載板全球前五大



臻鼎科技控股

Zhen Ding Tech. Holding

Q&A



THANK YOU